

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/172**2020/EØS/7/24****av 16. november 2018****om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddematerialer for å oppnå en stabil elektrisk forbindelse mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med integrerte kretser^(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr⁽¹⁾, særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på bruksområdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU.
- 2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som direktiv 2011/65/EU får anvendelse på (kategori 1–11), er oppført i vedlegg I til nevnte direktiv.
- 3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av bly i loddematerialer for å oppnå en stabil elektrisk forbindelse mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med integrerte kretser ble imidlertid unntatt fra begrensningen og står for tiden oppført i punkt 15 i vedlegg III til nevnte direktiv. Utløpsdatoen for dette unntaket var 21. juli 2016 for kategori 1–7 og 10.
- 4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden.
- 5) Blyholdige loddematerialer brukes i Flip Chip-forbindelser som loddeperler for å feste skive til kapsling. Loddematerialer må kunne motstå elektromigrasjonsfeil ved den svært høye strømtettheten som kreves, og må kunne skape en lagdelt lodding som muliggjør trinnvis montering og omarbeiding av komponenter i framstillingsprosessen. De må også ha høy duktilitet, slik at termomekanisk stress reduseres i UBM-strukturer (Under Bump Metallurgy), særlig i større skiver.
- 6) For noen bruksområder som omfattes av gjeldende unntak, er det på grunn av mangel på pålitelige alternativer fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne bly. Unntaket svekker ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006⁽²⁾. Det bør derfor fornyes for disse bestemte bruksområdene.
- 7) For alle andre bruksområder som for tiden omfattes av unntaket, er vilkårene for fornyelse ikke oppfylt. Unntaket for disse bruksområdene bør fortsette å gjelde i 12 måneder etter datoen for ikrafttreddelsen av dette delegerte direktiv, i samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2011/65/EU.
- 8) Ettersom det for bruksområdene som berøres av fornyelsen, ennå ikke finnes pålitelige alternativer på markedet, bør unntaket for disse bruksområdene fornyes for kategori 1–7 og 10 for det maksimale tidsrommet på fem, år til 21. juli 2021. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen.

^(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88.

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1).

- 9) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoen oppføres i vedlegg III til nevnte direktiv.
- 10) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel 16. november 2018.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

VEDLEGG

I vedlegg III erstattes punkt 15 med følgende:

«15	Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk forbindelse mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med integrerte kretser	Får anvendelse på kategori 8, 9 og 11 og utløper — 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, — 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i kategori 8, — 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter i kategori 9 og for kategori 11.
15(a)	Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk forbindelse mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med integrerte kretser, der minst ett av følgende kriterier gjelder: — En halvlederteknologinode på 90 nm eller mer. — En enkelt skive på 300 mm ² eller mer i enhver halvlederteknologinode. — Stacked Die-pakker med skivestørrelse på 300 mm ² eller mer, eller silisiummellomlegg på 300 mm ² eller mer.	Får anvendelse på kategori 1, 7 og 10 og utløper 21. juli 2021.»